

2016年5月13日

マルチプロセス対応パッケージボンダ FPB-1s NeoForce 受注開始

株式会社新川（社長：長野高志、東京都武蔵村山市伊奈平二丁目 51 番地の 1）は、新たなマルチプロセス対応パッケージボンダプラットフォーム「FPB」を開発し、第一弾として基板向け装置である「FPB-1s NeoForce」の受注を開始します。

当社は、従来より、コンピュータ・通信機器の高速化・低消費電力化のキーとなる TSV を用いた 3 次元実装で必要とされる TCB(*1)工法に注力してきました。一方、フリップチップボンダ市場では、現在、高精度マスリフロー工法が普及しており、昨今は FO-WLP(*2)等の新しい工法の提案もなされています。このような市場動向を踏まえ、TCB 工法に加え、C2(*3)、C4(*4)、FO-WLP 等の各種工法に対応した装置を開発しました。

同機種は、独自の NVS(*5)技術により、高精度なボンディングを可能とするとともに、FFG(*6)により 350N までの高荷重に対応することで、従来機より 2.4 倍(*7)の生産性向上を実現しました。また、高速パルスヒータを用いた短時間加熱・冷却により、高スループットの TCB 実装を可能とするなど、当社の技術を結集した装置となっています。



【FPB-1s NeoForce の特長】

- (1) Face down 工法対応 (Face up 工法はオプション)
- (2) TCB 工法 (NCP(*8)/NCF(*9)/TC-CUF(*10))、C2、C4 工法、FO-WLP 工法等に対応
- (3) NVS 技術により、高精度なボンディングを実現
- (4) FFG により、350N までの高荷重に対応
- (5) 高速パルスヒータを用いた短時間加熱・冷却により、高スループットの TCB 実装を実現
- (6) 品種自動交換ユニットにより、2.5D、3D 積層等の多品種ボンディングに対応
- (7) 薄ダイハンドリングに対応

【パッケージボンダ FPB-1s NeoForce】

*1: Thermal Compression Bonding *2: Fan-out Wafer Level Package *3: direct Chip Connection
*4: Controlled Collapse Chip Connection *5: Non Vibration System *6: Force Free Gantry
*7: 当社実験条件における比較 *8: Non-Conductive Paste *9: Non-Conductive Film
*10: Thermal Compression Capillary Underfill

■ その他当社取扱製品

ワイヤボンダ、ダイボンダ、フリップチップボンダ

■ お問い合わせ先

お客様お問い合わせ担当：グローバル営業統括部 志村 達也（TEL：042-560-1225）

報道機関お問い合わせ担当：経営企画部 森 琢也（TEL：042-560-4848）

以上